|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE PRODUCTO**  **REFERENCIA**  **PROCESO** | | Módulo de Flujo Laminar  JPCFLVMD96IX | | | | **MODELO**  **ORDEN DE PEDIDO**  **ORDEN DE PRODUCCIÓN** | | | 2019  2019120  2019120-E | | |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | | | **CONTROL ACTIVIDAD** | | | **REALIZADO POR** | | | **REVISADO POR** | **FECHA** |
| **FECHA** | **OPERARIO** | |
| 1 | Perforación de los agujeros de sujeción de la PCB, con broca de diámetro de 1/8” | | | Verificar que la perforación tenga el diámetro adecuado | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 2 | Realizar los Through-hole de la tarjeta | | | Verificar cada uno de los Trough-hole con el fin de garantizar que ambas capas se encuentren comunicadas. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 3 | Soldar las resistencias de la tarjeta | | | Verificar que los valores de las resistencias estén acorde al esquemático y el sentido de las resistencias. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 4 | Soldadura de conectores GP | | | Verificar que el sentido del GP corresponda a lo establecido en el manual de ensamble electrónico. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 5 | Soldar los componentes con empaquetado TO-220 | | | Verificar que la referencia de cada componente coincida con el esquemático y la orientación del mismo. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 5 | Soldadura de Borneras | | | Verificar que las borneras queden en el sentido correcto y sean de la cantidad de pines de acuerdo al esquemático. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 6 | Soldadura de Regletas profesionales | | | Verificar que se encuentre soldada correctamente sin separaciones de la regleta en la capa top. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 7 | Sujeción de Disipador | | | Verificar que el disipador se encuentra bien sujetado tanto a la PCB como al TRIAC. Verificar visualmente la soldadura y verificar que tenga mica aislante. | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 8 | Soldadura de componentes pasivos y activos (condensadores, cristales de quarzo, opto acopladores, Triac) | | | Verificar que los valores de los componentes coincidan con el esquemático. Además verificar el sentido de los componentes. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | |  |  |
| 9 | Realizar la etapa de pruebas de funcionamiento de la tarjeta, siguiendo los lineamientos del manual de ensamble electrónico | | | Verificar que las mediciones obtenidas en la etapa de pruebas de la tarjeta correspondan a las mediciones esperadas de acuerdo al manual de ensamble. | | |  |  | |  |  |
| 10 | Realizar la preparación de la caja eléctrica del equipo y el cableado de la misma | | | Verificar que los componentes y el sistema de organización de cables se encuentren ubicados de forma correcta. Verificar que las conexiones se encuentren de acuerdo al plano eléctrico. | | |  |  | |  |  |
| 11 | Realizar la preparación del panel de control | | | Verificar que la etiqueta del panel se encuentre instalada correctamente. Verificar que los botones, Display y elementos de mando se encuentren instalados correctamente | | |  |  | |  |  |
| 12 | Realizar la conexión del panel de control con la caja eléctrica | | | Verificar que las conexiones entre ambas partes se encuentres aseguradas y marcadas correctamente. | | |  |  | |  |  |
| 13 | Realizar la conexión de la caja eléctrica con los actuadores y sensores del equipo | | | Verificar las conexiones de las luces, motores y sensores. | | |  |  | |  |  |
| **Despeje de línea realizado por:**  **Fecha:** | | | **Despeje de línea verificado por:**  **Fecha:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  VoBo DIRECTOR TÉCNICO Fecha | | | | | | |